

1-8-2-3 糊付着短絡／胶迹的短路 / Short by adhered adhesive

【特徴】 銅めっき面の糊状短絡

【特征】 镀铜面有胶迹的短路。

【Characteristics】 Short on the plated copper surface caused by adhesive residue

【原因・判断ポイント・発生工程】 DFR ラミネート前の銅めっき表面に付着した糊が ET レジストとなった為出来たもの（DFR ラミネート前～ET 工程）

【原因、判断要点、发生工序】 在 DFR 压合前，镀铜层的胶迹成为 ET 剂而引起的（DFR 压合前～ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 Adhesive adhered on plated copper surface before dry film lamination acts an etching resist causing the defect. (Before dry film lamination - etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率 × 100

【注釋】
显微镜倍率 × 100

【Comments】
Magnification: ×100



【コメント】
顕微鏡倍率 × 100

【注釋】
显微镜倍率 × 100

【Comments】
Magnification: ×100

1-8-3 露光被り短絡／妨碍曝光的短路 / Caused by photographic fogging

1-8-3-1 AWF 下異物短絡／在 AWF 下面有杂物的短路 / Short by a foreign object under a phototool

【特徴】 対面する導体の両側から突起状に出た頂点で繋がった形の短絡

【特征】 导线的两侧凸出，顶点相接的短路。

【Characteristics】 Short caused by conductor projections protruding from both of conductors facing each other and connecting at their tips.

【原因・判断ポイント・発生工程】 ネガタイプ AWF の不透明部下の導体間隔部に異物が介在し、AWF が浮き上った為露光被りして出来たもの（露光焼付～ET 工程）

【原因、判断要点、发生工序】 在 AWF 不透明下面的导线间夹杂杂物，导致 AWF 隆起，妨碍曝光而引起的（曝光～ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 Photographic fogging caused by lift-up of a negative pattern phototool at the opaque area between conductors by a foreign object forms the defect. (Imaging - etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
FPC
FPC 顕微鏡倍率 ×

【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×

【Comments】
FPC
Magnification: ×